



課程概述 Course Description

課程代碼 Course Code	中文課程名稱 Course Name(Chinese)	英文課程名稱 Course Name(Chinese)	總學分數 Credits	總時數 Hours	冊別 Hours
03245	半導體構裝技術	Semiconductor Fabrication Technology	3	3	1
中文概述 Chinese Description	本課程主要是介紹半導體構裝技術之相關製程如晶片至電路板及構裝至電路板連結、密合及封裝、與製造過程等細節。而主要課程內容有: 構裝連線技術與材料、印刷電路板、塑膠與陶瓷構裝、銲接材料與先進構裝技術。				
英文概述 English Description	This course provides a detail introduction on chip-to-board and package-to-board connections, sealing and encapsulation, and manufacturing process in the microelectronic packaging. The course deals with the electrical interconnections and materials, ceram				